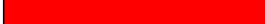







① Размеры для справок

② Проводящий рисунок на плате выполнить в соответствии с данными проектирования МПСУ.464342.21-005Д1 и данными конструкции МПСУ.464342.21-005Т5М

Стек	Материал	Слой	Толщина	Тип
		Top Overlay		Legend
	Маска	Top Solder	0.01	Solder Mask
	Фольга 1	Top Layer	0.02	Signal
	Core		0.51	Dielectric
	Фольга 2	Bottom Layer	0.02	Signal
	Surface Material	Bottom Solder	0.01	Solder Mask
		Bottom Overlay		Legend
Total thickness: 0.56				

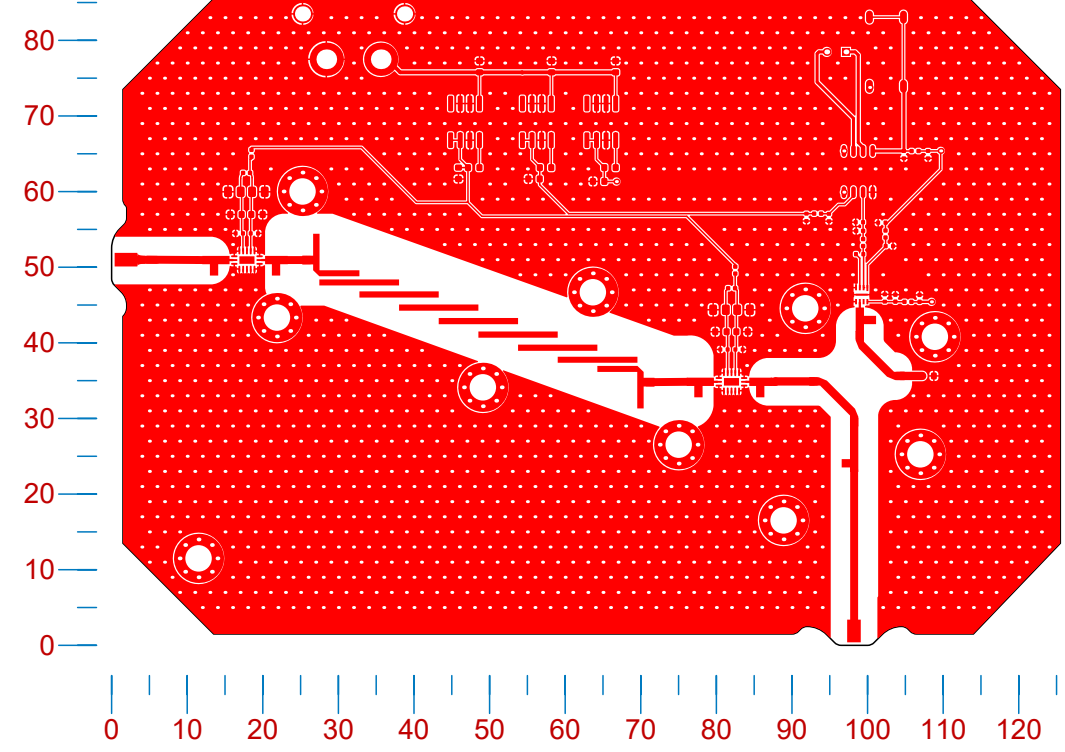
					МПСУ.687254.21-005СБ						
					Приёмная ячейка	Лит.		Масса		Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		у					3:2
Разраб.	Лазба										
Проверил	Приходько										
Т. контр.											
Нач. отд					Сборочный чертёж		Лист	1	Листов	3	МИЭТ
Н. контр.											
Утв.											

A

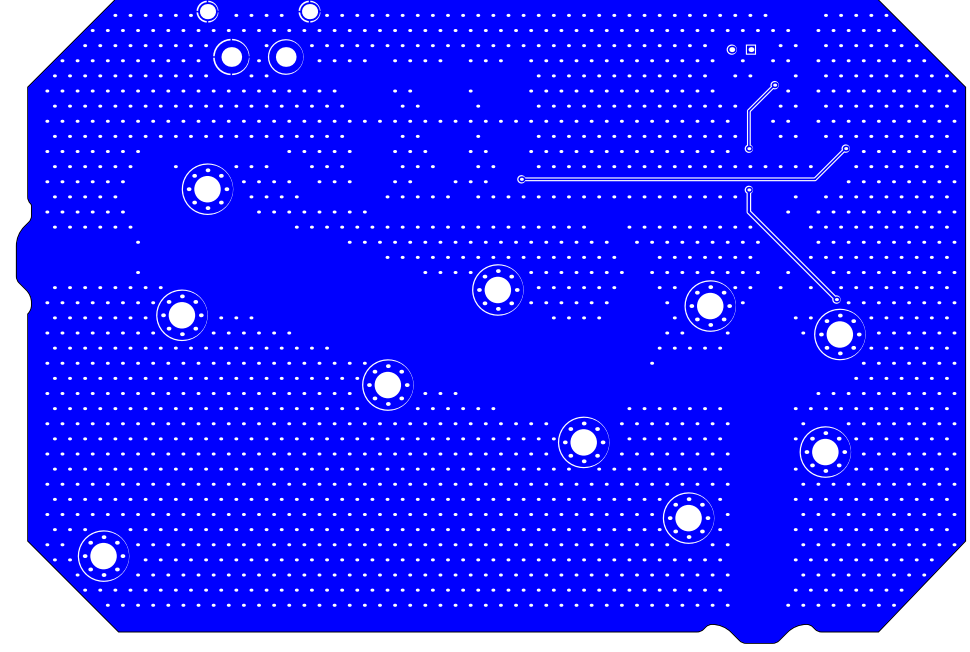
B

МПСУ.687254.21-005СБ

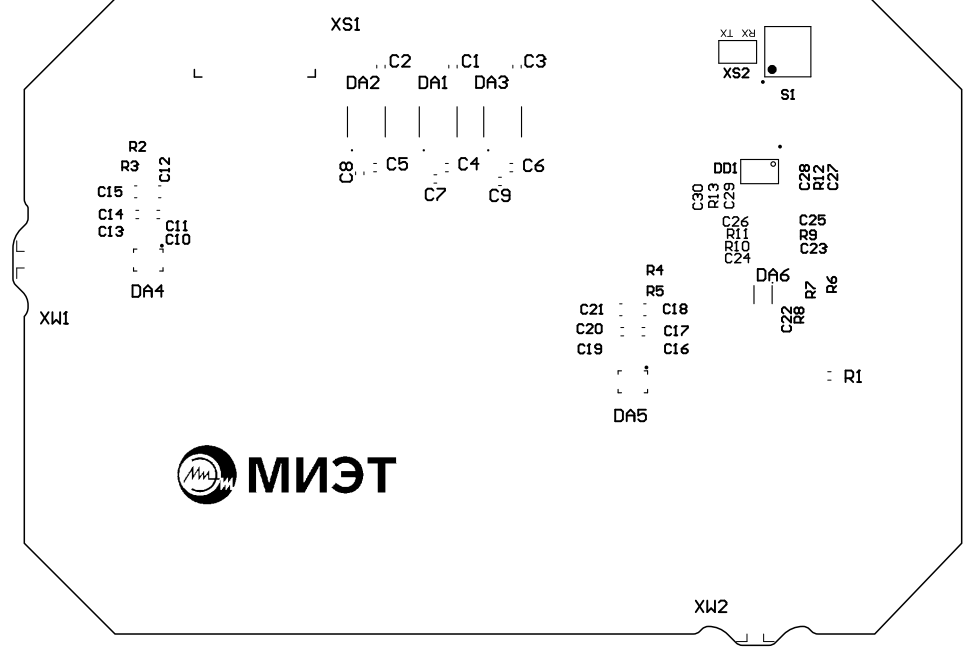
Top Layer (1:1)



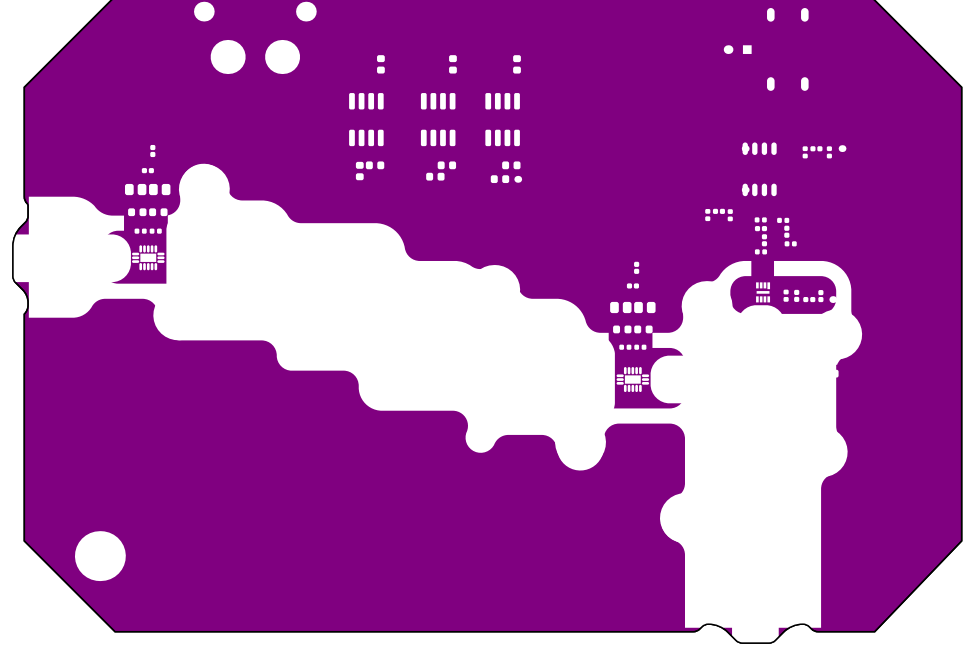
Bottom Layer (1:1)



Top Overlay (1:1)



Top Solder (1:1)



Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

A

B

Копировал

Формат А3

Карта сверловки

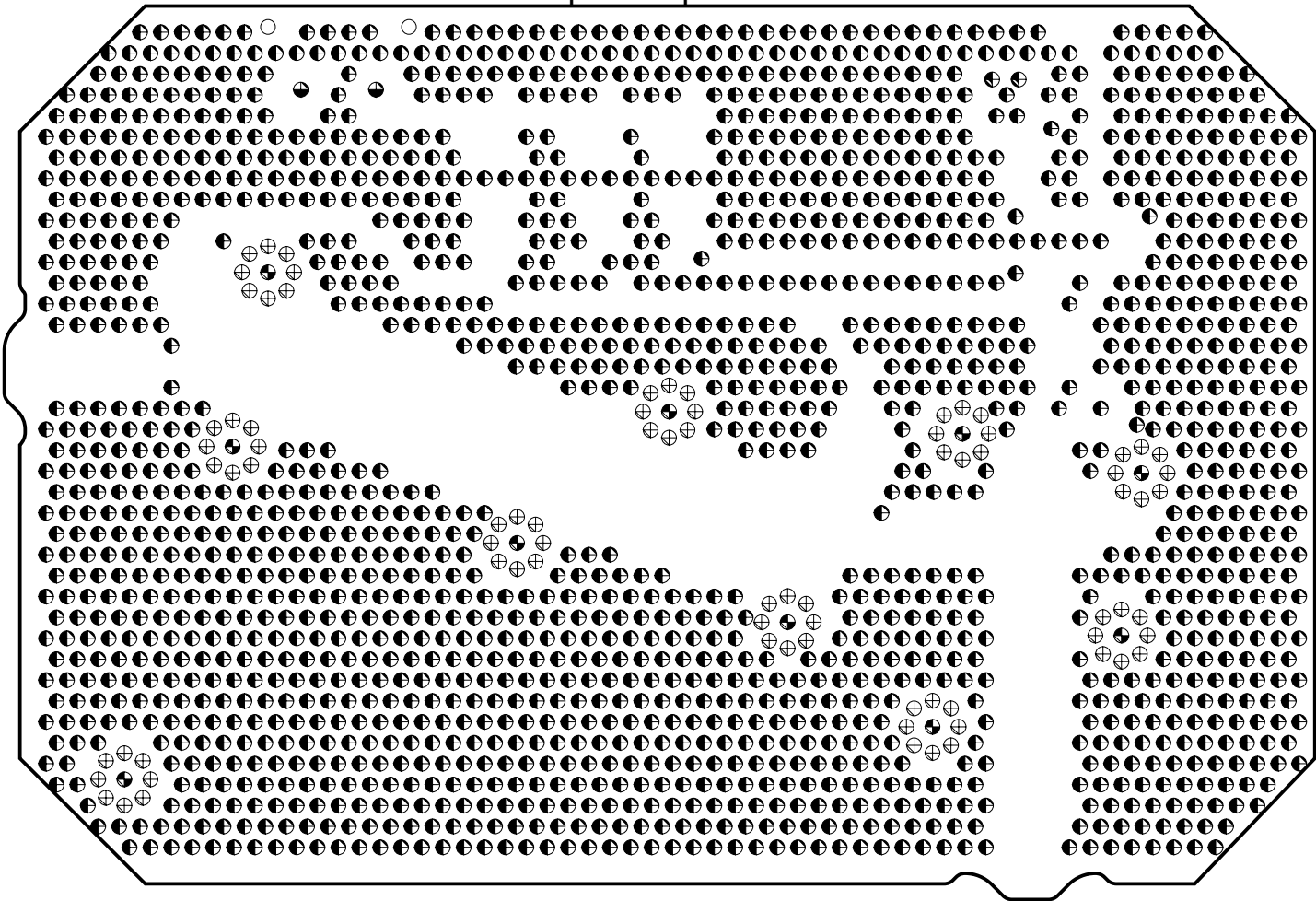


Таблица Отверстий

Символ	Количество	Размер	Металлизация	Слой
⊕	1689	0.40mm	Есть	Top Layer - Bottom Layer
⊕	80	0.50mm	Есть	Top Layer - Bottom Layer
⊕	2	0.65mm	Есть	Top Layer - Bottom Layer
○	2	2.00mm	Есть	Top Layer - Bottom Layer
⊕	2	2.60mm	Есть	Top Layer - Bottom Layer
⊕	10	3.50mm	Есть	Top Layer - Bottom Layer
	1785 Total			

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата